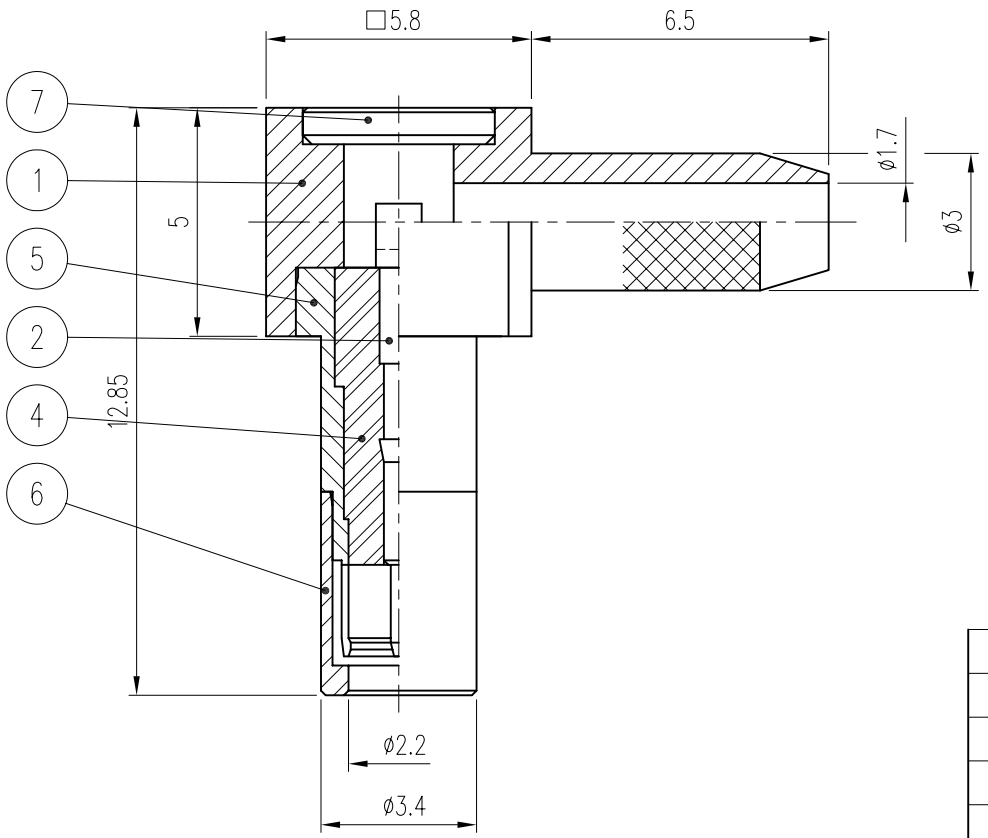
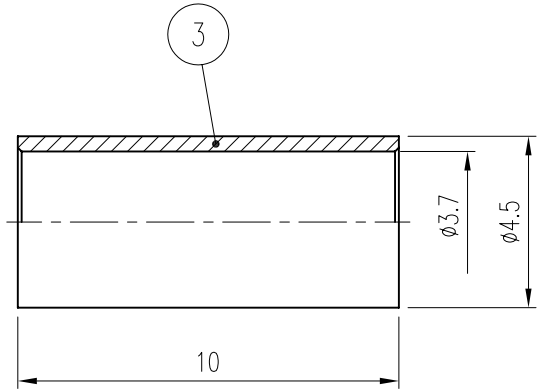
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

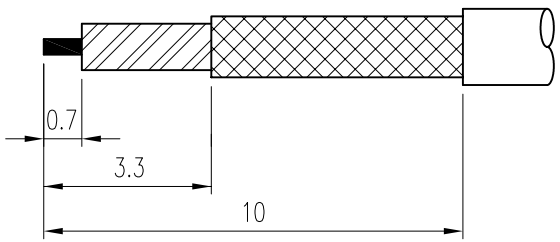
수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일





품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
7	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCO00017-5/2 (L1014)
6	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00133-5/1
5	JACK	1	BeCu	Gold Plate	DJA00110-5/1
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01289-N/1
3	FEERULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00043-5/1 (F6007)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01520-5/1
1	BODY (A)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01992-5/1



CABLE 탈피도

대체가능재질	년월일	2008. 4. 19.	
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	승인		
	검도		
재질	제도		
열처리	작성부서	연 구 소	
보호피막처리	척도 6/1	단위 mm	중량 —

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 KMS-LP FUJIKURA VER.0

A4

도번 CN01991-7/1